

Title (en)
DEVICE AND METHOD FOR HOT-DIP COATING A METAL STRIP WITH AT LEAST TWO LAYERS

Title (de)
VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM SCHMELZTAUCHBESCHICHTEN EINES METALLBANDES MIT MINDESTENS ZWEI SCHICHTEN

Title (fr)
DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE REVÊTEMENT PAR IMMERSION À CHAUD D'UNE BANDE MÉTALLIQUE AVEC AU MOINS DEUX COUCHES

Publication
EP 3561133 A1 20191030 (DE)

Application
EP 19168561 A 20190411

Priority
DE 102018206185 A 20180423

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zum Schmelztauchbeschichten eines Metallbandes (1) mit mindestens zwei Schichten, mit einem Durchlaufofen zum Durchleiten und Erwärmen des Metallbandes (1), mit einem in Laufrichtung des Metallbandes (1) hinter dem Durchlaufofen angeordneten ersten mit einer Schmelze (11.1) gefüllten Gefäß (11) und mit mindestens einem zweiten mit einer Schmelze (12.1) gefüllten Gefäß (12), mit einem zwischen dem Durchlaufofen und dem ersten Gefäß (11) angeordneten Rüssel (13) zum Durchleiten und Einleiten des Metallbandes (1) in die Schmelze (11.1) im ersten Gefäß (11), mit einem zwischen den Gefäßen (11, 12) angeordneten Übergang (11.2) zum Durchleiten des Metallbands (1), mit mindestens einer im zweiten Gefäß (12) angeordneten Umlenkrolle (15) zur Umlenkung und Ausleiten des Metallbandes (1) aus dem zweiten Gefäß (12), wobei an dem Übergang (11.2) mindestens ein elektromagnetisches Mittel (14) angeordnet ist.

IPC 8 full level
C23C 2/00 (2006.01); **C23C 2/06** (2006.01); **C23C 2/12** (2006.01); **C23C 2/40** (2006.01); **C23C 28/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)
C23C 2/00344 (2022.08 - EP US); **C23C 2/00348** (2022.08 - EP US); **C23C 2/0036** (2022.08 - EP US); **C23C 2/06** (2013.01 - EP); **C23C 2/12** (2013.01 - EP); **C23C 2/40** (2013.01 - EP); **C23C 28/025** (2013.01 - EP)

Citation (search report)

- [YD] DE 102013101131 A1 20140807 - THYSSENKRUPP STEEL EUROPE AG [DE]
- [Y] DE 10316138 A1 20041028 - SMS DEMAG AG [DE]
- [Y] JING LI ET AL: "The Rresearch of Permanent Magnet Sealing Technology in Vertical Hot Galvanized Pot", PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND ELECTRONICS ENGINEERING (ICCSEE 2013), 1 January 2013 (2013-01-01), XP055609032, ISBN: 978-90-78-67761-1, DOI: 10.2991/iccsee.2013.751

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3561133 A1 20191030; EP 3561133 B1 20230215; DE 102018206185 A1 20191024

DOCDB simple family (application)
EP 19168561 A 20190411; DE 102018206185 A 20180423